

性能特点

- 本系列灌封胶适用于各种灌封模式
- 100%固态，固化后无渗出物
- 卓越的耐高低温性，极好的耐气候性，耐辐射及卓越的介电性能
- 化学性能和机械性能稳定

产品描述

PAKCOOL® TPC-230 是具有高导热性能的 1:1 双组分液态电子灌封材料，可在室温或加温下固化。除高导热的特性外，本产品还具有热膨胀率低和绝缘性高等特点，从而更加有效地消除电子元件因工作温度变化产生的破坏作用。本系列产品亦广泛地用于粘合成发热的电子器件和散热片或金属外壳。在固化前本产品有较好的流动性和流平性。固化后也不会因为冷热交替使用而从保护外壳中脱出。其灌封表面光滑并无挥发物生成。

典型应用

- LED 组装
- 逆变器
- 高频变压器
- 电源模块
- 汽车电池包
- 通讯设备
- 电子部件

注意事项

- 本产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砷、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等
- 因为 A/B 组分的粘度略有差异，如采用机器灌封，需对 B 组分的压力略做调整
- 存放过程中，产品会有填料沉降，属于正常现象，使用前需要将 A、B 组分在各自的桶内刮底刮壁充分搅拌均匀后，再以 1:1 进行混合并充分搅拌至颜色均匀

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。

技术参数

特性	TPC-230	测试方法
基材	双组分 RTV	--
颜色	A:白色 B:灰色	Visual
A/B 混合比例	1:1	--
粘度 (cP)	≤32,000	ASTM D2196-15
操作时间 (min @ 25°C)	>20	--
导热系数 (W/m·K)	2.9	ASTM D5470
硬度 (Shore A)	50±5	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.00±0.10	ASTM D792
介电强度 (kV/mm)	≥14	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	≥3x10 ¹³	ASTM D257
阻燃	V-0	UL 94
保质期 (@室温)	12 个月	--
连续使用温度 (°C)	-50 至+200	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

储存条件

- PAKCOOL® TPC-230 需阴凉干燥处储藏

包装规格

- 1Kg/罐、25Kg/桶和 50Kg/桶的包装规格

固化时间

- TPC-230 硅胶在室温下放置 8 至 48 小时即可自然固化。其交联时间将随温度升高而缩短（参见下表）。

25°C	24 小时
70°C	40 分钟